集成电路产业技术创新战略联盟成立

2017 年 3 月 22 日，由 62 家龙头企业、高校、研究院所和社会组织等共同发起的“集成电路产业技术创新战略联盟”在北京成立。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家集成电路产业投资基金相关负责同志出席联盟成立大会，共同为联盟揭牌并致辞。业内资深专家及骨干单位代表等 120 余人参加了会议。

成立大会之前，联盟召开了第一届理事会会议，选举科技部原副部长曹健林研究员为理事长；选举国家外国专家局原局长马俊如研究员为专家咨询委员会主任；选举“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”国家科技重大专项技术总师魏少军、“极大规模集成电路制造装备与成套工艺”国家科技重大专项技术总师叶甜春、阿里巴巴集团首席架构师林晓东、360 公司首席安全官谭晓生、联想集团高级副总裁贺志强、中兴通讯公司首席科学家向际鹰、上汽集团总工程师程惊雷、京东方董事长王东升、中国电子信息产业集团副总经理陈旭、中国电科集团副总经理张冬辰、中芯国际董事长周子学、紫光集团董事长赵伟国、上海华虹集团董事长张素心、华润微电子常务副董事长陈南翔、江苏长电董事长王新潮、通富微电子董事长石明达、天水华天董事长肖胜利、北方华创名誉董事长王岩、中微半导体董事长尹志尧、上海硅产业集团董事长王曦、示范性微电子学院产学融发展联盟理事长严晓浪等为副理事长；选举魏少军为常务副理事长、叶甜春为秘书长。在成立大会上，新当选的曹健林理事长、马俊如主任发表了重要讲话。

集成电路产业技术创新战略联盟成员单位业务范围涵盖互联网应用、信息系统集成，电子产品整机制造、集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测、集成电路装备材料和零部件等。联盟将以国家战略为指引，以突破集成电路前沿技术为目标，鼓励开放式创新，促进产业链各环节的交流合作，优化产业技术创新的生态环境；探索各类资源协同的新机制，汇聚联盟内外和国内国际的创新资源和力量，推动产业技术水平的快速提升；促进“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”、“极大规模集成电路制造装备与成套工艺”、“新一代宽带无线移动通信网”等 3 个重大专项成果的对接与深度融合；深入系统研究集成电路产业技术创新可持续发展战略，为“十三五”电子与信息领域重大专项顺利实施及后续集成电路的协同创新提供支撑，为我国及全球集成电路产业技术创新和发展做出贡献。CRC

未来三年：全球新增半导体产线 62 条 中国占 26 条

2017 – 2020 年间，全球将新增半导体产线 62 条，其中 26 条新增产线在中国大陆，占比 42%。

据不完全统计，我国目前已开增产线为 15 条，将于 2018 年陆续建成投产。

过去几年，我国半导体新增产能主要为外资厂商在华建厂房及扩产，中国本土厂商主要参与者仅有中芯国际。2017 – 2020 年，我国半导体新增产能主要为本土芯片生产商，在“设备国产化”需求的政策引导下，国产设备将取得更多机会进入本土芯片生产线。

随着国内产线的陆续开建、投产，半导体设备及厂务规划等企业将优先受益。同时，新增产能开出后，我国 12 寸及 8 寸晶圆制造产能大幅度增加，对后段封测的需求明显提高。CRC